

TWSE: 6215

和椿科技股份有限公司

法人說明會

2026.08.11





投資安全聲明

- 本簡報所提供之資訊，係基於本公司目前可得之資料與內部分析結果，並包含對未來的展望與預測。
- 本簡報中的陳述涉及特定未來事件，這些展望可能受到各種已知及未知風險、變數及其他因素之影響，導致實際結果與預測產生重大差異。
- 本公司不對本簡報所提供資料的正確性、完整性或時效性負任何法律責任，亦無義務隨時更新或修正本簡報內容。
- 本簡報所述內容僅供參考，不構成任何投資建議或邀約，投資人應自行審慎評估與判斷。
- 如有任何疑問，請以本公司依法公開之財務報告與公告為準。



簡報大綱

- 公司簡介
- 產業趨勢與核心競爭力
- 未來布局
- 財務報表

公司簡介



和椿科技簡介



重要日期

成立：1980 年 11 月

上櫃：2002 年 12 月

上市：2007 年 12 月

董事長

張以昇

發言人

何頌胤 副總經理

服務據點

總公司：台北市內湖區洲子街 60 號 1 樓

營運總部位於台北市內湖區，營業據點位於桃園、台中、台南、上海、深圳

台灣生產基地位於桃園蘆竹、龜山；中國生產基地位於江蘇昆山

服務項目

代理：傳動 / 驅動 / 感知精密零組件

自研：控制元件 / 產線設備與次系統

整合：機器人與自動化解決方案

實收資本額

NTD 827,896,930

員工人數

320 人



經營理念

以客戶需求導向，為企業夥伴解決痛點、創造價值。
並以「誠信務實」與「勇於挑戰」的態度自我期許，讓企業本身能與時俱進，不斷學習與成長。

Aurotek

Automation + Robot + Technology



動能控制 Motion & Control

精密傳動元件與驅動技術，奠定自動化穩定基石



智能感測 AI & Intelligence

結合 AI 與感測系統，賦予設備自主感知與分析能力



機器人整合 Robotics Solutions

智慧製造、物流與服務應用，全面實現自動化轉型

全球嚴選合作夥伴



產業趨勢與核心競爭力



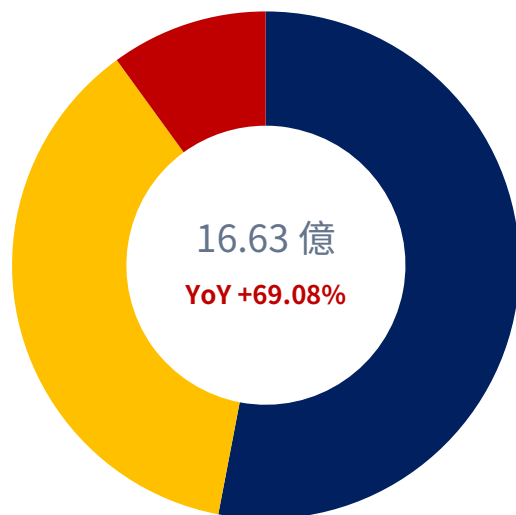
和椿科技產品演進

	1980~1998	1999~2023	2023~2024	2025~
產品主題	自動化零組件	自動化設備	AI 機器人	AI 機器人
主力產業	自動化設備製造	半導體 / 電子製造	半導體 / 電子製造	半導體 / 電子製造 傳統產業/零售服務等
主要產品	控制卡 精密零組件	SMT 產線設備 控制卡 精密零組件	功能型機器人 半導體製程關鍵次系統 SMT 產線設備 控制卡 精密零組件	人形機器人 功能型機器人 半導體製程關鍵次系統 SMT 產線設備 控制卡 精密零組件



營運概況 — 產品別營收占比

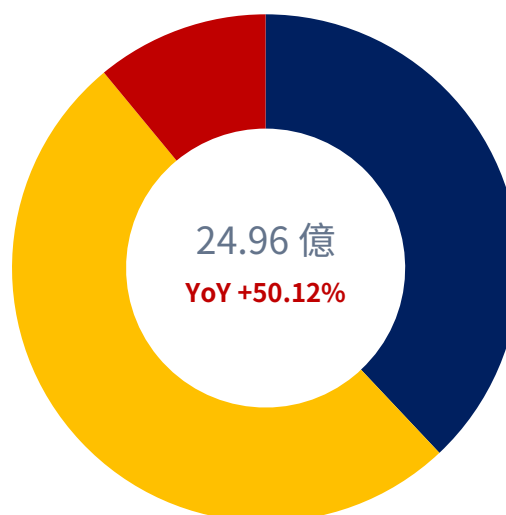
和椿正由過去高度集中於自動化零件代理的營收結構
轉型為機器人解決方案與設備與次系統並行的多元引擎經營模式



2024

機器人 10%
自動化設備與次系統 37%
自動化零組件 53%

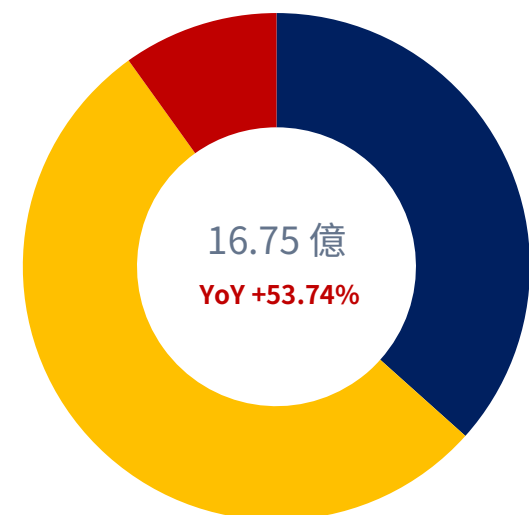
● 自動化零組件



2025

機器人 11%
自動化設備與次系統 51%
自動化零組件 38%

● 自動化設備與次系統



2026 1H

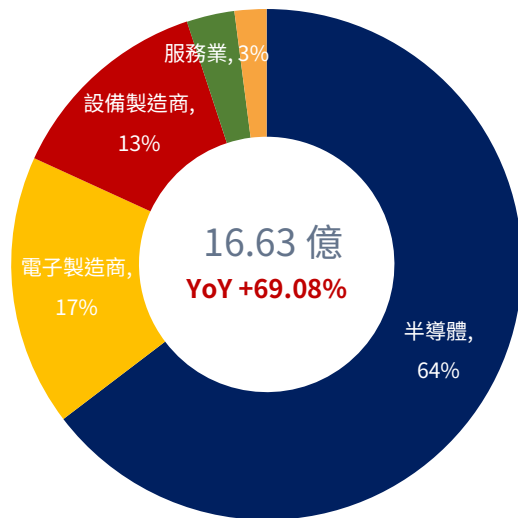
機器人 10%
自動化設備與次系統 54%
自動化零組件 36%

● 機器人及其他

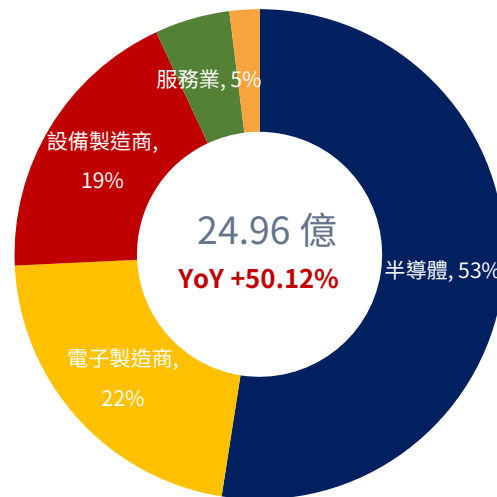


營運概況 — 產業結構持續穩定

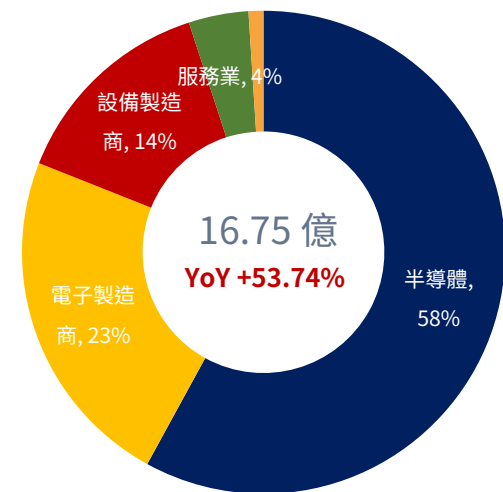
營收來源，占比最大者為半導體產業50%以上，電子製造產業 20%



2024



2025



2026 1H



半導體擴產與供應鏈在地化

2030 年全球半導體產值展望

突破 1 兆美元

以 8.6% 的年複合成長率強勁增長

全球半導體設備支出

7.4% 投資成長

其中超過七成集中在亞洲

晶圓產能年複合 CAGR 擴張

7.0% (2030E)

技術與地緣兩大力量推升結果

剛性需求驅動力

- ✓ **先進封裝轉向 Chiplet 架構：**小晶片 (Chiplet) 異質整合成為主流，高密度互連趨勢帶動對「高精度次系統」與自動化設備的迫切需求。
- ✓ **在地化採購提升維護效率：**因應供應鏈重組，在地化採購能有效提升設備利用率。
- ✓ **供應鏈自給自足趨勢：**全球各大區競相實現供應鏈自主，強化在地供應韌性。

資料來源：[PwC 2026 全球半導體展望報告：半導體與未來](#)

和椿科技半導體次系統佈局

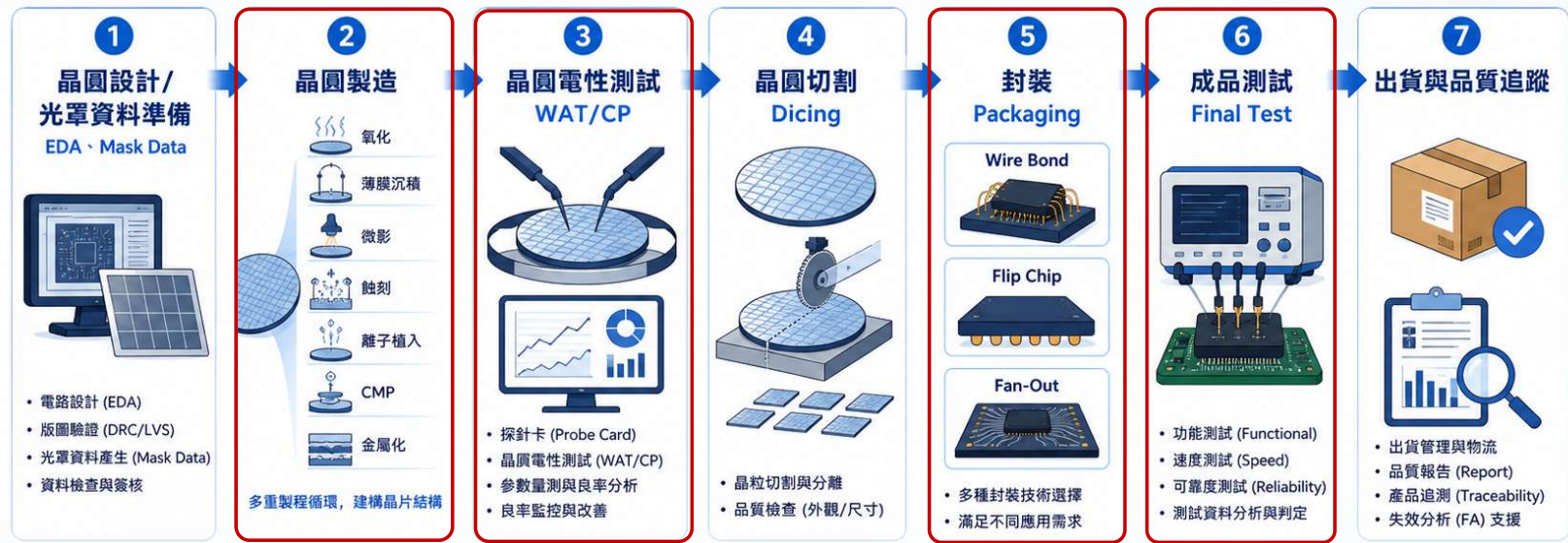
聚焦協助半導體設備客戶，於成品測試環節提供高精度次系統，打造在地化與高彈性供應鏈雙引擎。

- **精密對位次系統：**滿足半導體成品測試高精度定位需求，提升良率與生產效率。
- **在地化即時服務：**降解全球供應鏈中斷風險，客製化彈性服務。





半導體產業的關鍵系統夥伴



成品測試應用設備

最終測試設備(Final Test)

- ATE 測試機
- 測試介面板
- 測試軟體
- Handler 機台



系統層級測試(SLT)

- SLT 測試平台
- 模擬系統環境
- 高速訊號測試
- 散熱與電源模擬



老化測試設備(Burn-in)

- 溫控系統
- 電源供應
- 自動化機台



服務項目



製程整合

整合製程技術，優化產品性能與成本



製程監控

即時監控製程狀態，確保製程穩定



良率提升

數據分析與改善，持續提升良率



工程變更

ECO 管理與變更導入，確保順利量產



品質管理

品質系統與稽核管理，確保產品品質



客戶報告

提供完整報告與分析，強化客戶合作

SMT 產線設備生態鏈與中長期成長動能

2035F 全球 SMT 市場規模

135.6 億美元

由 2026 年 64 億美元 穩健成長 (CAGR 8.7%)

機構估算 CAGR 區間

4.7% – 9.5%

技術升級與產能擴建 推動未來 10 年翻倍成長

東南亞產能轉移占比

18.0% (2026E)

供應鏈分散趨勢，帶動區域性設備採購高峰

三大核心成長驅動力 (Key Market Drivers)

- ✓ **AI 視覺檢測與高良率需求：**AI 推動貼裝良率向上挑戰 99.9%，觸發新一輪精密檢測與貼裝設備汰換潮。
- ✓ **車用電子精密貼裝升級：**電動車 (EV) 動力控制器與 BMS 電池管理系統升級，推升高精度 SMT 製程採購需求。
- ✓ **東南亞產能移轉潮：**2026 年東南亞產能占比翻倍至 18%，新廠建置掀起 SMT 後製程與檢測設備拉貨高峰。

資料來源：MarkWide Research(202605)；ResearchAndMarkets (2026)

和椿科技 SMT 產線關鍵設備佈局

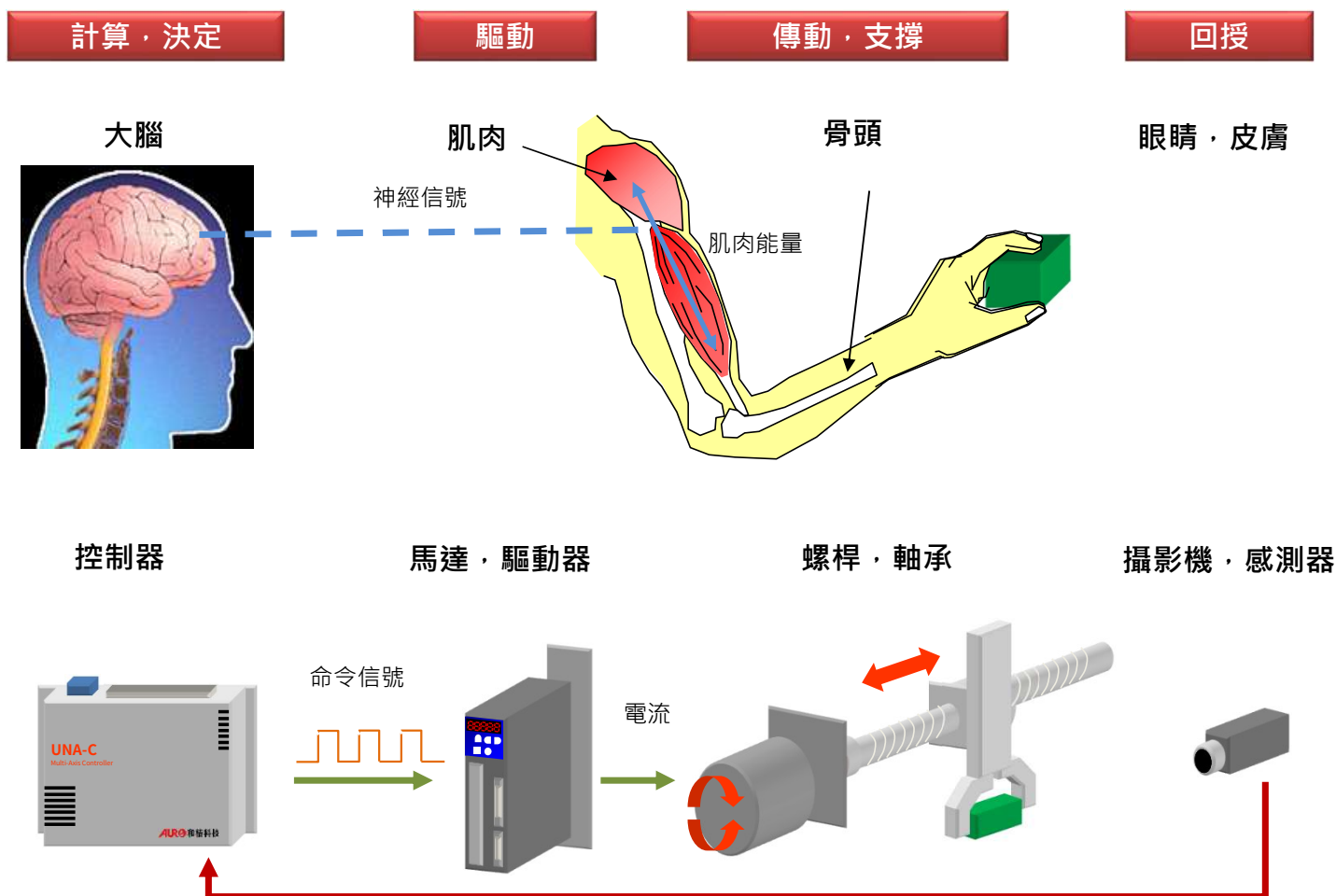
深耕 SMT 自動化設備，配合客戶海內外產線佈局，提供高度整合之產線設備與零件：

- 擴張產品線與服務範圍：從 SMT 產線主要設備、周邊及零件，延伸至廠內外自動化機器人應用，滿足產線智慧化升級需求





提供客戶一站式解決方案



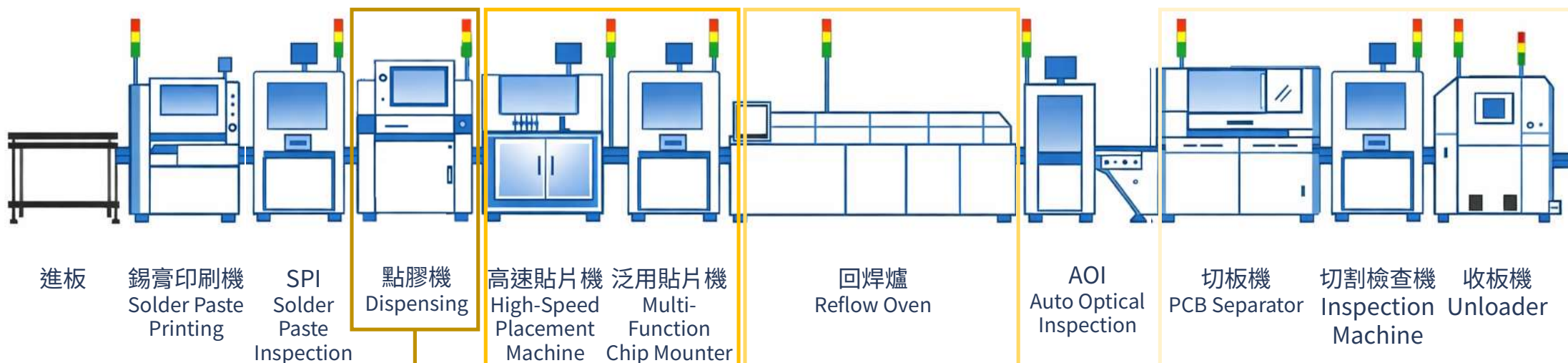


從精密組件到 SMT 切板設備整合





SMT 產線對應設備



前端製程

點膠機



其他周邊設備

SMT 智能倉儲
真空壓力烤箱



焊接製程周邊設備

爐溫監控智能系統
回流焊影像監控器
殘氧測試儀
回流焊軌道性能測試套件
真空版爐溫測溫儀



2026 新品

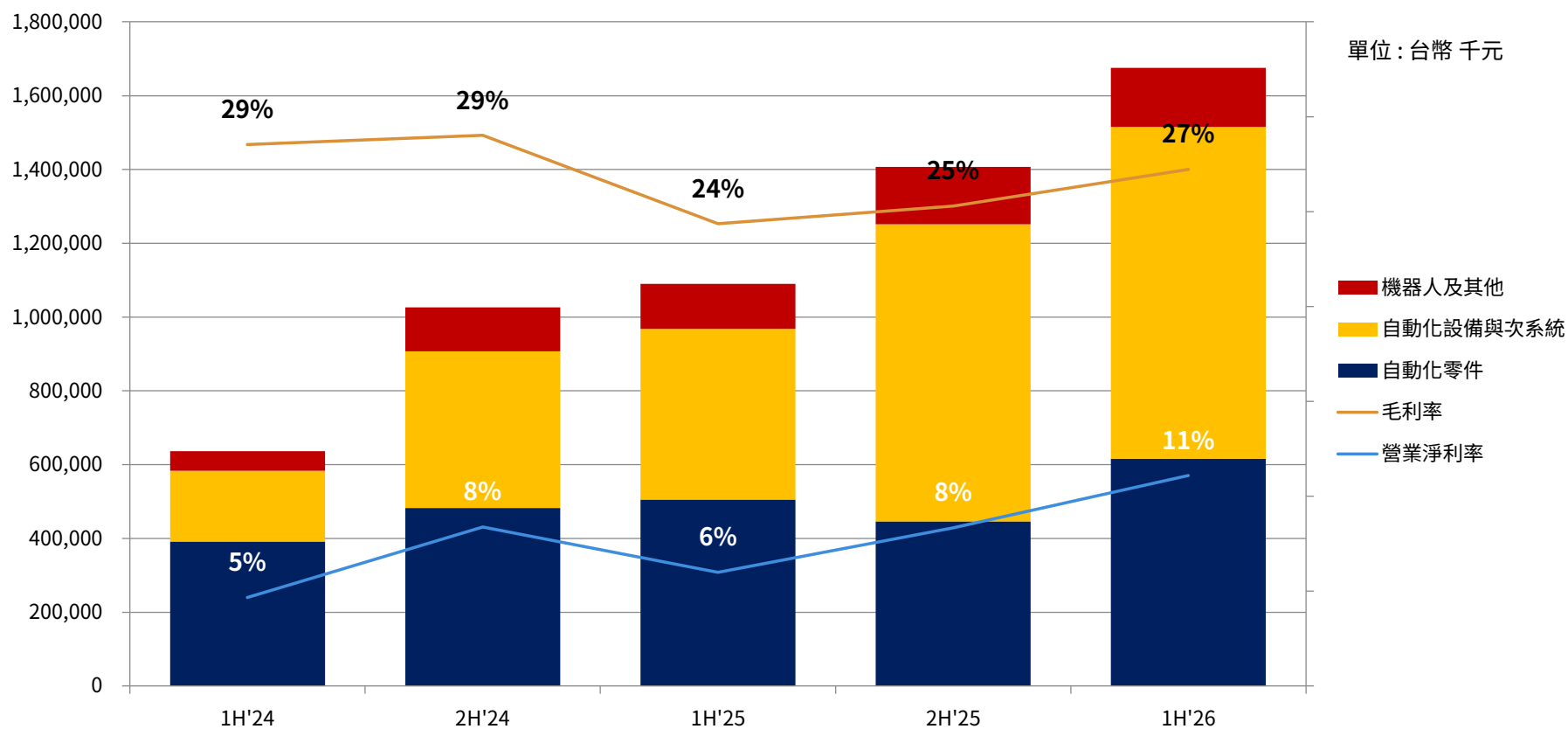
後段製程

切板機
切割檢查機
收板機



既有主力產品

銷售分析 – 歷年營收趨勢



項目	1H'24	2H'24	1H'25	2H'25	1H'26
自動化零件	62%	47%	46%	32%	37%
設備與次系統	30%	41%	42%	57%	54%
機器人及其他	8%	12%	11%	11%	10%
營業收入淨額	636,406	1,026,540	1,089,700	1,406,708	1,675,306

©2026 Aurotek Co., Ltd. All rights reserved.

全球機器人市場擴張：AMR 與物流搬運主流

2035F AMR 市場規模

170.0 億美元

由 2026 年 34 億美元 飆升 (CAGR 19.5%)

物流搬運機器人占比

> 40%

位居智慧倉儲與智慧工廠搬運市場第一大主流

雙軌驅動核心因素

高齡與缺工

功能型 AMR 進入穩健高成長爆發期

全球機器人雙軌發展趨勢 (Dual-Track Robotics)

- ✓ **高齡化與勞動力缺口：**全球人口結構變遷，廠內搬運與自動化轉型已從「選配」成為產業「剛性需求」。
- ✓ **功能型機器人 (AMR/AGV) 成為主流：**物流搬運佔整體市場比重超過 40%，扮演無人化智慧工廠的核心樞紐。

資料來源：[Global Market Insights \(TEJ\)](#)；[IFR《2025世界機器人報告》](#) · 2026

和椿科技 AMR 自主移動機器人佈局

持續合作國際知名機器人品牌，加大力道觸及倉儲物流領域，提供完整的物流搬運機器人解決方案。



人形機器人爆發與半導體級驗證絕對優勢

⚡ 2027E 人形機器人出貨量

> 10 萬台

預估年增率達 > 700% 的爆發式成長

💖 陪伴型機器人產值 (2030E)

11.0 億美元

高齡化與獨居趨勢崛起帶動「陪伴經濟」

🛡️ 和椿核心技術壁壘

絕對優勢

半導體級嚴苛驗證轉移至機器人模組

💧 人形機器人商用化關鍵趨勢 (2026–2027)

- ✓ **商用化門檻跨越**：2026 年正式邁入商用元年，2027 年全球出貨將以超過 700% 爆發式翻倍突破 10 萬台。
- ✓ **陪伴經濟龐大需求**：獨居人口與高齡化少子化加速，陪伴型人形機器人獲得強勁剛性需求支撐，2030 年產值達 11 億美元。
- ✓ **零組件精密性要求提升**：關節致動器、高精度減速機與控制器要求達到「零微米級」極限誤差。

資料來源：TrendForce (2025-12/2026-07)、Counterpoint Research (2026-05)

⚙️ 「半導體級驗證」形成的絕對優勢

已將功能型產品進駐半導體晶圓廠區，符合嚴苛驗證標準，未來將持續拓展功能型機器人應用於各大產業，構築機器人競爭壁壘。



核心業務與未來成長動能

核心事業

自動化設備&零組件

半導體製程次系統

SMT 產線設備

自動化零組件

✓ 已進入，穩定現金流

成長事業

功能型機器人

智慧製造



智慧物流



智慧服務



✓ 已進入，快速成長

未來動能

人形機器人
Physical AI



人形機器人

數據採集中心

真實世界數據採集
工業廠景應用導入

↑ 布局中，卡位未來賽道

未來布局



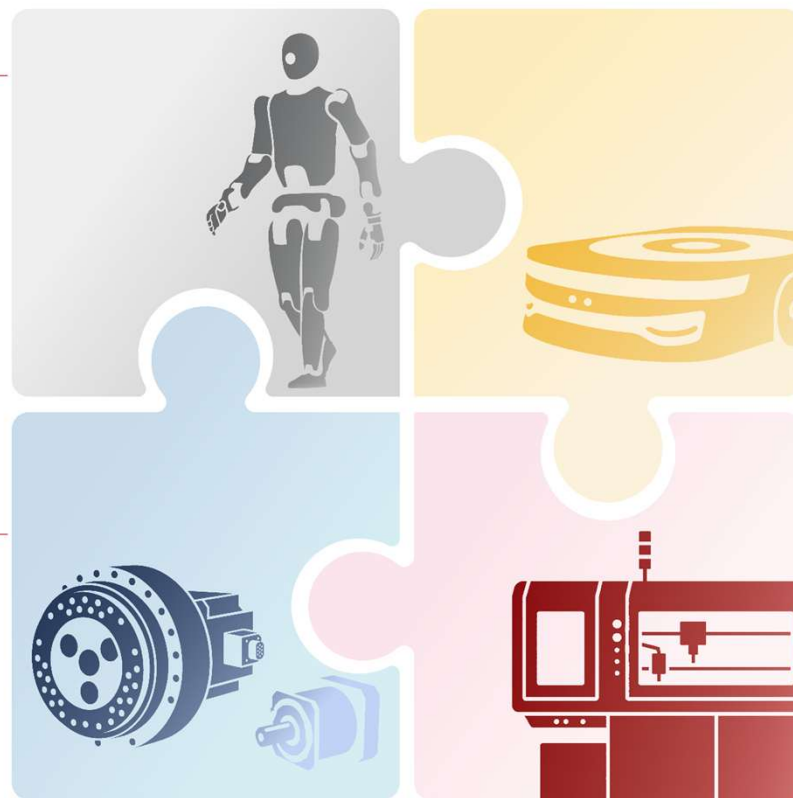
全價值鏈布局，創造完整產業服務能力

人形機器人

- **數據採集：**多元場域感測器資料與作業流程數據整合採集
- **場域應用資料庫：**累積跨產業應用場域知識庫，加速模型訓練
- **各產業落地交付：**機器人系統整合、部署與維運全程服務

自動化零組件

- **半導體設備精密零組件：**晶圓製程、蝕刻、沈積、研磨
- **電子製造設備精密零組：**SMT、AOI、切割、測試



功能型機器人

- **智慧工廠：**協作手臂、搬運機器人
- **智慧服務：**遞送服務機器人、清潔機器人
- **智慧物流：**堆棧機器人、工業搬運機器人

設備與次系統

- **SMT 產線設備：**電子製造自有品牌設備與廠區周邊設備
- **半導體次系統：**聚焦成品測試關鍵次系統等服務項目



使命願景

使命

以AI與機器人為核心的解決方案提供者
解決高齡化與少子化衍生的產業困境

願景

推動智慧科技走入每個產業角落
打造機器人為服務的永續新未來

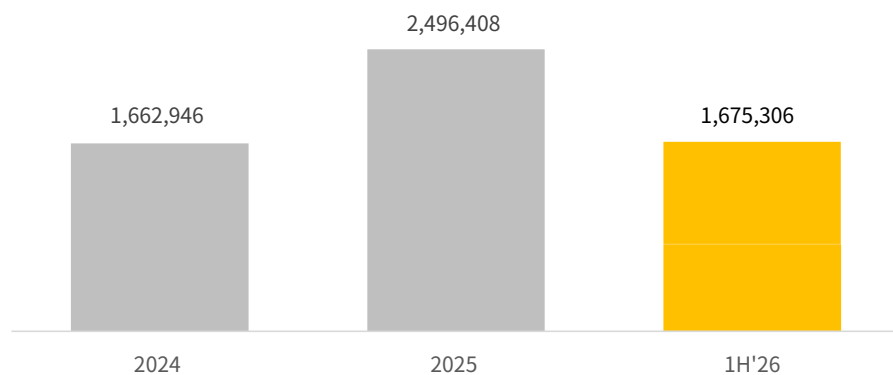


財務報表

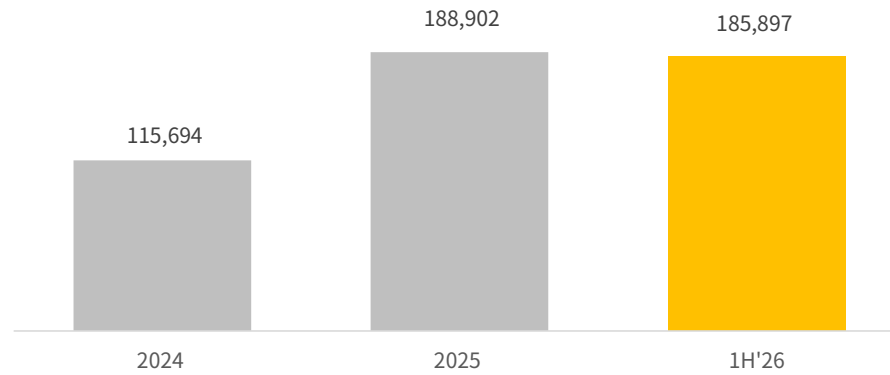


財務表現

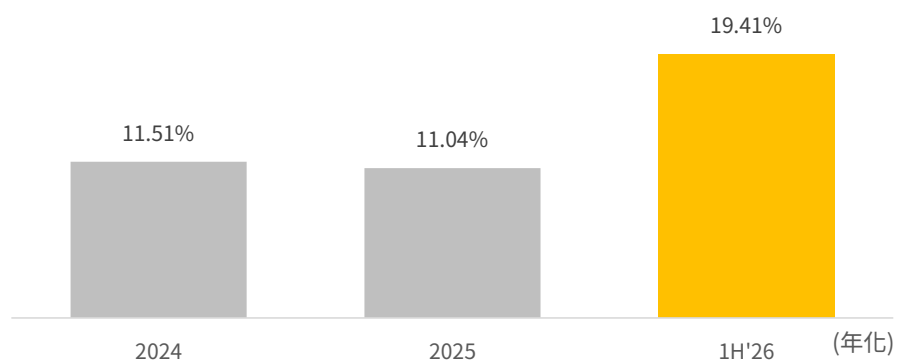
營業收入(NT\$ K)



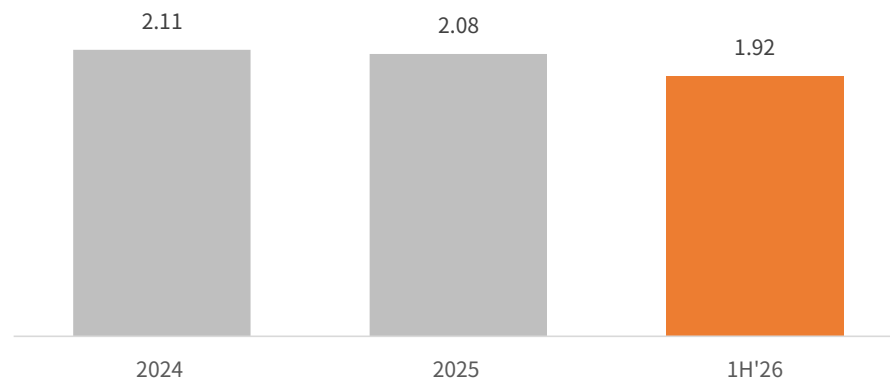
營業淨利(NT\$ K)



權益報酬率(%)



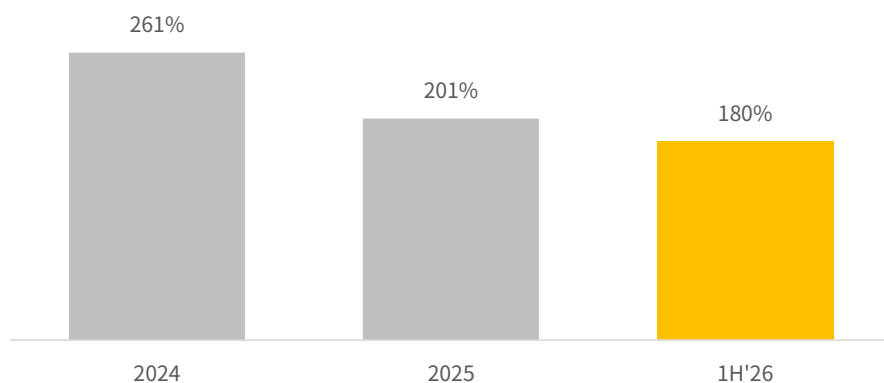
每股盈餘(NT\$)



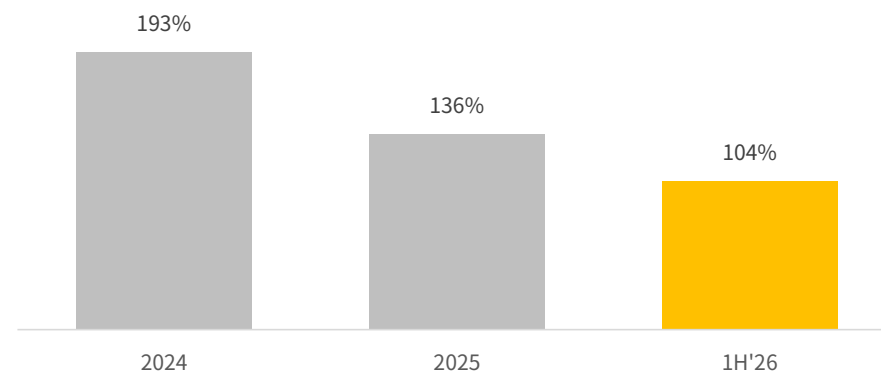


資產負債表管理

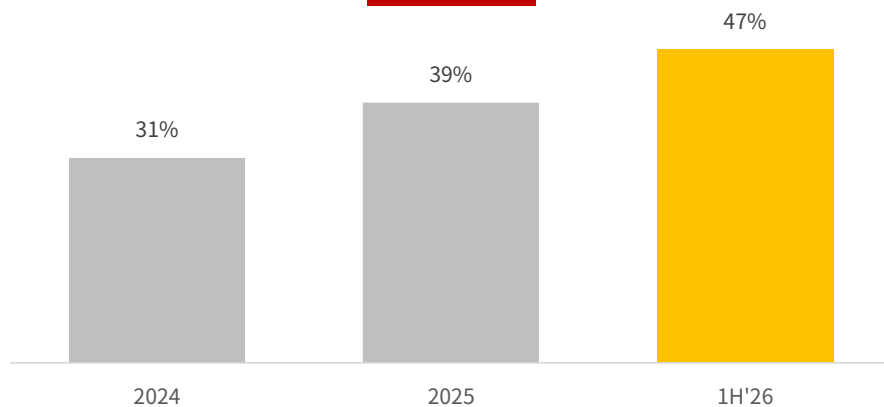
流動比(%)



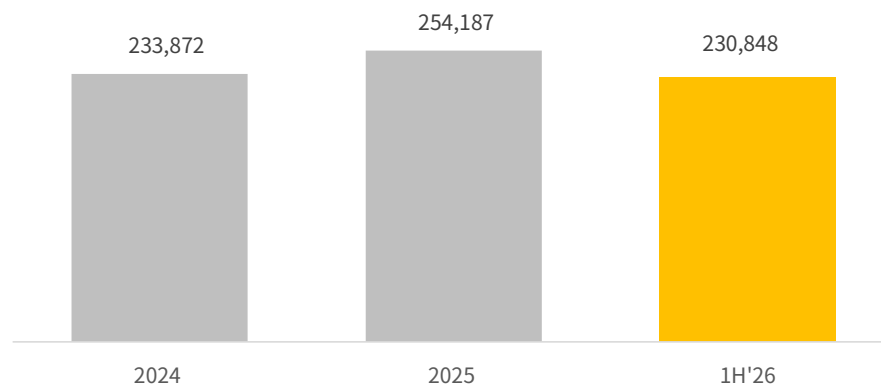
速動比(%)



負債比(%)



EBITDA(NTD\$ K)





資產負債表

單位：台幣 千元

	2026/6/30		2025/12/31		2025/6/30	
現金及約當現金	508,265	16%	401,029	15%	402,870	17%
應收票據及帳款	902,686	28%	874,042	33%	638,984	27%
存貨	1,032,338	32%	599,415	23%	547,914	23%
其它流動資產	20,197	1%	15,510	1%	68,196	3%
流動資產合計	2,463,486	77%	1,889,996	71%	1,657,964	71%
長期股權投資	79,360	2%	71,849	3%	66,138	3%
固定資產	318,027	10%	253,561	10%	250,391	11%
其它資產	319,801	10%	431,629	16%	375,541	16%
資產總計	3,180,674	100%	2,647,035	100%	2,350,034	100%
短期借款	200,000	6%	280,000	11%	115,000	5%
應付票據及帳款	796,003	25%	429,536	16%	395,477	17%
其他短期負債	373,519	12%	230,979	9%	304,428	13%
流動負債合計	1,369,522	43%	940,515	36%	814,905	35%
長期負債	130,252	4%	94,477	4%	102,062	4%
其他非流動負債	5,605	0%	5,826	0%	6,329	0%
負債合計	1,505,379	47%	1,040,818	39%	923,296	39%
股東權益	1,675,295	53%	1,606,217	61%	1,426,738	61%



綜合損益表

單位：千元

項目	1H 2026	1H 2025	YoY
營業收入	1,675,306	1,089,700	53.74%
營業毛利率	27%	24%	
營業費用	270,319	193,939	39.38%
營業淨利率	11%	6%	
本期淨利	159,273	53,527	197.56%
純益率	9%	5%	
每股盈餘(NTD)	1.92	0.65	



綜合損益表

單位：千元

	2Q 2026	1Q 2026	2Q 2025	QoQ	YoY
營業收入	902,205	773,101	602,543	16.70%	49.73%
營業毛利率	25%	30%	25%		
營業費用	(147,824)	(122,495)	106,322	20.68%	39.03%
營業淨利率	9%	14%	7%		
本期淨利	64,969	94,304	23,306	(31.11)%	178.77%
純益率	7%	12%	4%		
每股盈餘(NTD)	0.78	1.14	0.65		

Q & A 提問



和椿科技股份有限公司